

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **ASMPT LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

### **二零二五年中期業績新聞稿**

有關 ASMPT Limited 及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月業績的新聞稿附載於本公告。

承董事會命  
董事  
黃梓達

香港，二零二五年七月二十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：樂錦壯先生（主席）、張仰學先生、蕭潔雲女士及許明明女士；非執行董事：Hichem M'Saad 博士及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓達先生及 Guenter Walter Lauber 先生。

(本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。)



## ASMP T 公布二零二五年中期業績

### 人工智能浪潮推動強勁需求

#### 集團業績概覽

##### 關鍵亮點

- \* 新增訂單總額勝過預期
- \* TCB 在邏輯與記憶體領域具領導地位
- \* 主流業務開始受惠於人工智能
- \* 二零二五年上半年的毛利率超過 40%

##### 集團財務概要: 二零二五年第二季度

- \* 銷售收入為港幣 34.0 億元(4.36 億美元), 按年+1.8%, 按季亦+8.9%
- \* 新增訂單總額為港幣 37.5 億元(4.82 億美元), 按年+20.2%, 按季亦+11.9%
- \* 毛利率為 39.7%, 按年-33 點子, 按季亦-119 點子
- \* 經營利潤為港幣 1.69 億元, 按年+25.4%, 按季亦+5.9%
- \* 盈利為港幣 1.34 億元, 按年-1.7%, 按季則+62.6%
- \* 經調整盈利為港幣 1.35 億元, 按年-1.6%, 按季則+62.1%
- \* 每股基本盈利為港幣 0.32 元, 按年-3.0%, 按季則+60.0%
- \* 經調整每股基本盈利為港幣 0.32 元, 按年-3.0%, 按季則+60.0%

##### 集團財務概要: 二零二五年上半年

- \* 銷售收入為港幣 65.3 億元(8.38 億美元), 按年+0.7%, 按半年則-3.3%
- \* 新增訂單總額為港幣 71.1 億元(9.13 億美元), 按年+12.4%, 按半年亦+10.5%
- \* 毛利率為 40.3%, 按年-65 點子, 按半年則+121 點子
- \* 經營利潤為港幣 3.29 億元, 按年-12.2%, 按半年則+79.5%
- \* 盈利為港幣 2.17 億元, 按年-30.9%, 按半年則+672.7%
- \* 經調整盈利為港幣 2.18 億元, 按年-30.7%, 按半年則+95.7%
- \* 每股基本盈利為港幣 0.52 元, 按年-31.6%, 按半年則+642.9%
- \* 經調整每股基本盈利為港幣 0.52 元, 按年-31.6%, 按半年則+92.6%

##### 二零二五年第三季度銷售收入預測

- \* 將介乎 4.45 億美元至 5.05 億美元之間, 以其中位數計按年+10.8%, 按季亦+8.9%

詳盡業績公告及投資者簡報可見於

<https://www.asmpt.com/en/investor-relations/financial-information/>

有關上述經調整盈利及經調整每股基本盈利之詳情, 請參閱集團二零二五年第二季度業績公告「香港財務報告會計準則計量對非香港財務報告會計準則計量之對賬」一節。

(二零二五年七月二十三日，香港訊) — **ASMPT Limited** (「ASMPT」 / 「集團」 / 「公司」) (股份代號: 0522)，一間全球領先之半導體和電子產品製造的硬體和軟件解決方案供應商，公布集團截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績。

**集團行政總裁黃梓達先生表示:**「人工智能浪潮推動了先進封裝和主流業務的強勁需求，使我們於二零二五年上半年實現了勝過預期的新增訂單總額。我們一直保持着在人工智能企業的TCB市場領先地位，並推動着銷售收入增長。我們的主流業務正開始受惠於人工智能數據中心的需求，並且在中國電動車和消費者市場也實現了新增訂單總額增長。在此期間，我們的毛利率繼續高於40%以上。」

## 集團二零二五年上半年摘要

集團先進封裝 (「AP」) 業務持續增長，對二零二五年上半年集團的總銷售收入貢獻顯著，主要由熱壓焊接 (「TCB」) 工具的持續需求所推動。集團在記憶體及邏輯應用領域成功取得TCB工具的後續訂單，繼續保持最大的TCB安裝量，於全球超越500台。此外，在新能源管理功能的新增訂單總額增長中反映出集團的主流業務開始受惠於人工智能數據中心的需求。集團來自中國的新增訂單總額亦在電動車 (「EV」) 及消費者終端市場的推動下，錄得顯著增長。

- 銷售收入為港幣65.3億元 (8.38億美元)，按年增長0.7%，按半年則下降3.3%。半導體解決方案分部的銷售收入強勁增長，表面貼裝技術解決方案分部則下降。
- 新增訂單總額為港幣71.1億元 (9.13億美元)，按半年增長10.5%，按年亦增長12.4%。
- 表面貼裝技術解決方案分部的新增訂單總額按半年及按年均錄得強勁增長；半導體解決方案分部的新增訂單總額按半年下降但按年增長。未完成訂單總額為港幣68.5億元 (8.73億美元)，訂單對付運比率為1.09。
- 毛利率為40.3%，按半年上升121點子，但按年則下降65點子。按半年上升主要由於分部組合所推動，而按年下降則由於表面貼裝技術解決方案分部的銷量減少及不利產品組合所致。
- 營運支出 (「OPEX」) 為港幣23億元，按半年減少6.3%，按年則上升1.0%。儘管集團進行策略性研發及資訊技術基礎設施的投資，其審慎的支出管控及重組效益均推動營運支出按半年減少。
- 經營利潤達港幣3.29億元，按半年增長79.5%，按年則下降12.2%。按半年改善主要由毛利率改善及營運支出減少所推動。按年下降則主要受毛利率下降所致。
- 經調整經營盈利按半年增長95.7%至港幣2.18億元，按年則下降30.7%。按年下降主要由於外幣匯兌不利影響所致，而部分則被研發中心的稅項抵免優惠所抵銷。
- 資產負債表錄得穩健的現金及銀行存款為港幣50億元，保持強勁，淨現金為港幣23.3億元。
- 董事會宣布派發中期股息每股港幣0.26元。

## 先進封裝：增長潛力顯著

乘着強勁的人工智能浪潮，集團的先進封裝解決方案於二零二五年上半年佔集團總銷售收入的百分比按年增長至約 39%，或約 3.26 億美元。TCB 繼續為先進封裝的銷售收入作出最大貢獻。

TCB：由於集團的 TCB 進一步獲得主要人工智能企業的青睞，於二零二五年上半年的訂單按年上升 50%。在集團客戶群擴張的支持下，集團在邏輯和高頻寬記憶體（「HBM」）供應鏈中的 TCB 市場地位持續增強。

- **高頻寬記憶體**：集團獲得多個高頻寬記憶體企業的TCB訂單，加強其於高頻寬記憶體市場的領導地位，並成功完成為領先高頻寬記憶體客戶的12層HBM3E大宗TCB工具訂單的安裝。就HBM4而言，一個高頻寬記憶體客戶開始就集團的TCB進行12層HBM4小批量生產。
- **邏輯**：集團於二零二五年上半年在晶片到基底（「C2S」）應用的領先晶圓代工的外判半導體裝嵌及測試（「OSAT」）合作夥伴獲得額外的 TCB 訂單。集團作為晶片到基底的唯一供應商，並於二零二五年上半年大量交付這些 TCB 工具。集團與領先晶圓代工客戶共同開發用於超微間距晶片到晶圓（「C2W」）邏輯應用的新一代主動去除氧化 TCB 正從試產進展到批量生產。

混合式焊接（「HB」）：集團的第二代混合式焊接工具在對齊及焊接準確度、佔用空間、每小時產量方面均具備競爭能力。集團預期第三季度交付該第二工具予一名高頻寬記憶體客戶。

## 主流業務：人工智能及中國市場推動需求

得益於對新能源管理功能日益增長的需求，人工智能數據中心的需求已開始惠及集團的主流業務。二零二五年上半年，集團來自中國的訂單總額錄得強勁增長。在表面貼裝技術解決方案分部領域，主要受益於人工智能和電動車（該分部相關領域在中國仍為領先企業）。在半導體解決方案分部領域，消費性電子和電動汽車終端市場的外判半導體裝嵌及測試利用率有所提高。

## 集團第二季度財務摘要

- 銷售收入達港幣 34.0 億元（4.36 億美元），接近銷售收入預測的中位數，按季增長 8.9%，按年增長 1.8%。按季改善主要由於表面貼裝技術解決方案分部有所增長。
- 新增訂單總額為港幣 37.5 億元（4.82 億美元），按季增長 11.9%，按年亦增長 20.2%，這主要由於表面貼裝技術解決方案分部有所增長，而半導體解決方案分部則下降。其訂單對付運比率為 1.10，已兩個季度高於 1。
- 毛利率為 39.7%，按季下降 119 點子，按年亦下降 33 點子。按季下降主要由於半導體解決方案分部下降 161 點子，表面貼裝技術解決方案分部則上升 108 點子。如果使用二零二五年第一季度的外匯兌換率，毛利率會超過 40%。

- 營運支出為港幣 11.8 億元，按季增加 5.7%，按年則減少 1.8%。營運支出按季增加主要是由於策略性研發、資訊技術基礎設施投資及外匯兌換影響所致，部分被審慎的支出管控及重組效益所抵銷。
- 經營利潤為港幣 1.69 億元，按季增長 5.9%，按年亦增長 25.4%，按季增長主要由於銷售量增加影響，按年增長則主要由於營運支出減少及銷售量增加影響。
- 經調整盈利達港幣 1.35 億元，按季上升 62.1%，按年則下降 1.6%。按季改善主要由於經營利潤提升及來自研發中心的稅項抵免所致。

## 前景

集團預計二零二五年第三季度的銷售收入將介乎於 4.45 億美元至 5.05 億美元之間，以其中位數計按年增長 10.8%，按季亦增長 8.9%，高於市場預期。集團對取得可持續穩定的先進封裝銷售收入充滿信心，並預期表面貼裝技術解決方案分部的銷售收入亦將受惠。

展望未來，受惠於人工智能浪潮及集團在市場的技术領先地位，其有信心先進封裝將持續增長。集團重申其預測 TCB 總潛在市場將在二零二七年達到 10.0 億美元，並將繼續專注於鞏固其在記憶體和邏輯應用領域的 TCB 市場領導者地位。

集團的主流業務將受惠於來自中國市場的勢頭，以及由人工智能數據中心新興需求所帶來的機遇。然而，整體汽車及工業終端市場短期內將仍將疲軟。

儘管集團尚未受到關稅政策的負面影響，但認同存在不確定性。集團的全球影響力使其能夠靈活應對任何潛在影響，其將繼續密切關注局勢並根據需要進行調整。

## **關於 ASMPT Limited (「ASMPT」)**

ASMPT是一間全球領先之半導體及電子產品製造硬體及軟件解決方案供應商。ASMPT總部位於新加坡，產品涵蓋半導體裝嵌和封裝及SMT(表面貼裝技術)，從晶圓沉積乃至於各種幫助組織、組裝及封裝精細電子組件的解決方案，以便客戶用於各種終端用戶設備，如電子產品、移動通訊器材、計算設備、汽車、工業以及LED(顯示板)。ASMPT與客戶緊密合作，持續投資於研究及發展，開拓具有成本效益和行業影響力的解決方案，為提升生產效率、提高產品的可靠性和質素貢獻力量。ASMPT也是半導體氣候聯盟的創始成員之一。

ASMPT在香港聯交所上市(香港聯交所股份代號: 0522)，並且是恒生科技指數、恒生綜合市值指數下之恒生綜合中型股指數、恒生綜合行業指數下之恒生綜合資訊科技業指數、恒生可持續發展企業基準指數及恒生香港35指數之成份股。詳細資訊請查閱ASMPT網頁[www.asmpt.com](http://www.asmpt.com)。

## **前瞻性聲明**

除歷史事實陳述外，本文所有陳述均是或可能是前瞻性聲明。這些前瞻性聲明反映 ASMPT 根據現時可得的資料所作出的假設，目前對未來的期望、信念、希望、意圖或策略。此等前瞻性聲明並非就未來的表現或事件作出保證，並涉及已知或未知的風險和不確定性。因此，多種因素可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的資料有重大差別。讀者不應過分依賴此等前瞻性聲明，而 ASMPT 不會承擔任何義務公開地更新或修訂任何前瞻性聲明。除下文另有提及外，本文中無任何陳述有意或可被解釋為盈利預測。

- 完 -

## **新聞垂詢：**

林詒源 (Lim Ee Guan)

企業傳訊總監

電話：+65 6450 1445

電郵：[eg.lim@asmpt.com](mailto:eg.lim@asmpt.com)

代表 ASMPT：

## **縱橫財經公關顧問有限公司**

吳燕霞 / 梁頌欣 / 沈吉

電話：+852 2864 4812 / 2864 4862 / 2864 4870

傳真：+852 2527 1196

電郵：[mandy.go@sprg.com.hk](mailto:mandy.go@sprg.com.hk) / [vivienne.leung@sprg.com.hk](mailto:vivienne.leung@sprg.com.hk) / [angela.shen@sprg.com.hk](mailto:angela.shen@sprg.com.hk)